

ウェビナー申込書

R&D 支援センターウェビナー

「半導体パッケージ技術の最新動向＜FOWLP・SiP・チップレット・CoWoS＞【LIVE 配信】」

開催日時：2026 年 5 月 18 日（月）10:30～16:30

受講料：55,000 円（税込）

送信先 **Fax：03-3291-5789**

CMC リサーチ TEL：03-3293-7053

お名前 例) 山田 太郎	
フリガナ 例) ヤマダ タロウ	
法人名・会社名	
部署名	
郵便番号	
都道府県	
住所1 市区町村、番地等	
住所2 アパート・マンション名、部屋番号等	
メールアドレス	
電話番号	
FAX 番号	
メルマガ受信可否	☐ 受信する ☐ 受信しない
DM（郵便など）受け取り可否	☐ 受け取る ☐ 受け取らない
興味分野	
お支払い（銀行振込） 予 定 日	年 月 日頃
通 信 欄	